ACCRETECH | 東京精密

2026年度 (2027年3月期) 第2四半期 決算説明会

2026/11/04

株式会社東京精密

代表取締役社長CEO	**木村　龍一**
取締役 半導体社 執行役員カンパニー長	**伯耆田　貴浩**
計測社 執行役員カンパニー長	**石川　一政**
執行役員常務 CFO	**小泉　公人**

- **将来の事象に係わる記述に関する注意：** 本資料に記載されている情報, ならびに口頭で提供される情報は, 現時点で入手可能な情報をもとに, 当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは, 市況, 競争状況, 半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って, 今後の当社の実際の業績が, 本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- **用語について：**注記がある場合を除き, 半導体製造装置セグメントを「半導体」, 精密計測機器セグメントを「計測」, 親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」, 中期経営計画を「中計」と記載します。
- **記入データについて：** 記載されている金額や比率の情報は「億円」,またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為, 内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- **監査について：**本プレゼンテーション資料は, 監査法人による監査の対象外です。

エグゼクティブサマリー

2026年度 半期・第2四半期 業績	• 全社売上高・各利益・受注高それぞれ半期/四半期ピークを更新 • 半導体製造装置を中心に強い引合いが継続
2026年度 業績予想	• 8月4日開示の通期業績予想を上方修正 (全社売上高 1,890億円→1,920億円、営業利益440億円→450億円) • 売上高・営業利益とも中期経営計画定量目標の到達を予想 • 業績予想修正を受けて配当予想を更新(1株304円→316円)
2027年度以降の 考え方	• 当社対象市場の拡大は少なくともCY2028まで続く想定 • 2028年度半ばを目途にプローバ生産可能台数を倍増させる • 部材調達リスクは引き続き注視

2026年度 上期 連結業績

受注高、売上高、各利益は半期既往ピークを更新。半導体製造装置の受注高は1,000億円を超える水準

全社業績(億円)	2025年度上期	2025年度下期	2026年度上期	前半期比	前年同期比
受注高	806	825	**1,390**	+69%	+72%
売上高	771	898	**924**	+3%	+20%
営業利益	147	190	**203**	+7%	+38%
(利益率)	(19.1%)	(21.2%)	**(22.0%)**	+0.8pt	+2.9pt
経常利益	150	198	**211**	+7%	+41%
当期純利益	96	151	**155**	+2%	+61%
研究開発費	55	65	**68**	+4%	+22%
設備投資	69	42	**47**	+13%	-32%
減価償却費	27	29	**29**	+1%	+11%

セグメント別業績		2025年度上期	2025年度下期	2026年度上期	前半期比	前年同期比
半導体製造装置	受注高	613	621	**1,141**	+84%	+86%
	売上高	594	685	**726**	+6%	+22%
	営業利益	123	161	**177**	+10%	+44%
	(利益率)	(20.8%)	(23.5%)	**(24.4%)**	+0.9pt	+3.6pt
計測機器	受注高	193	204	**249**	+22%	+29%
	売上高	177	213	**198**	-7%	+12%
	営業利益	24	29	**26**	-11%	+10%
	(利益率)	(13.5%)	(13.8%)	**(13.3%)**	-0.5pt	-0.2pt

2026年度 第2四半期 連結業績

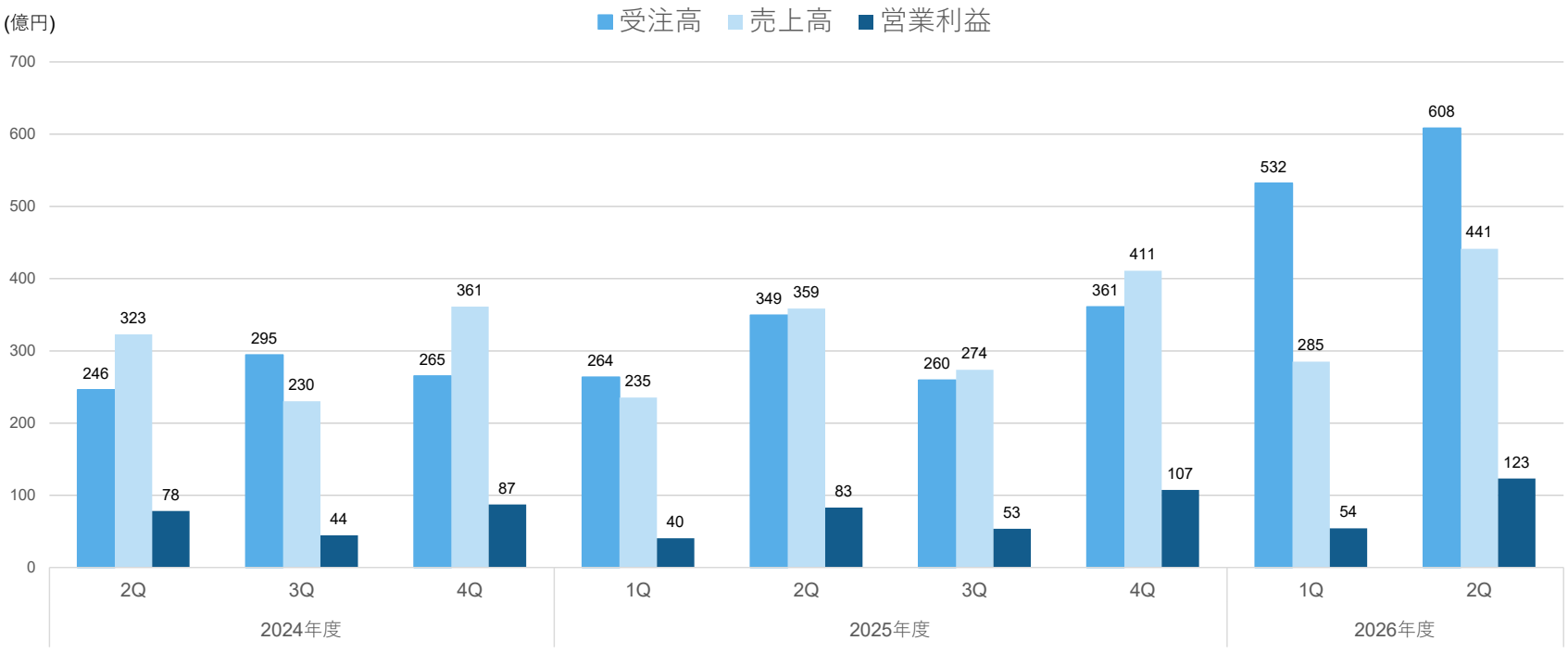
第2四半期業績は既往ピークを更新、売上高は計画を約40億円上回り、営業利益率も改善

全社業績(億円)	2025年度 1Q	2Q	3Q	4Q	2026年度 1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	359	447	366	458	658	731	+11%	+64%
売上高	309	462	359	539	367	557	+52%	+21%
営業利益	46	101	62	128	59	144	+144%	+42%
(利益率)	(14.8%)	(21.9%)	(17.3%)	(23.8%)	(16.1%)	(25.9%)	+9.8pt	+4.0pt
経常利益	45	105	67	131	64	147	+129%	+40%
当期純利益	32	64	45	106	47	108	+132%	+70%
研究開発費	25	30	29	36	33	34	+3%	+13%
設備投資	25	44	15	27	19	28	+43%	-37%
減価償却費	12	14	14	16	14	15	+5%	+5%

セグメント別業績		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
半導体製造装置	受注高	264	349	260	361	532	608	+14%	+74%
	売上高	235	359	274	411	285	441	+55%	+23%
	営業利益	40	83	53	107	54	123	+128%	+48%
	(利益率)	(17.1%)	(23.1%)	(19.5%)	(26.1%)	(19.0%)	(27.9%)	+8.9pt	+4.8pt
計測機器	受注高	95	98	107	97	126	123	-2%	+26%
	売上高	73	103	85	128	82	116	+41%	+12%
	営業利益	5	18	9	21	5	21	+313%	+15%
	(利益率)	(7.5%)	(17.8%)	(10.2%)	(16.3%)	(6.2%)	(18.3%)	+12.0pt	+0.5pt

半導体製造装置セグメント　業績推移

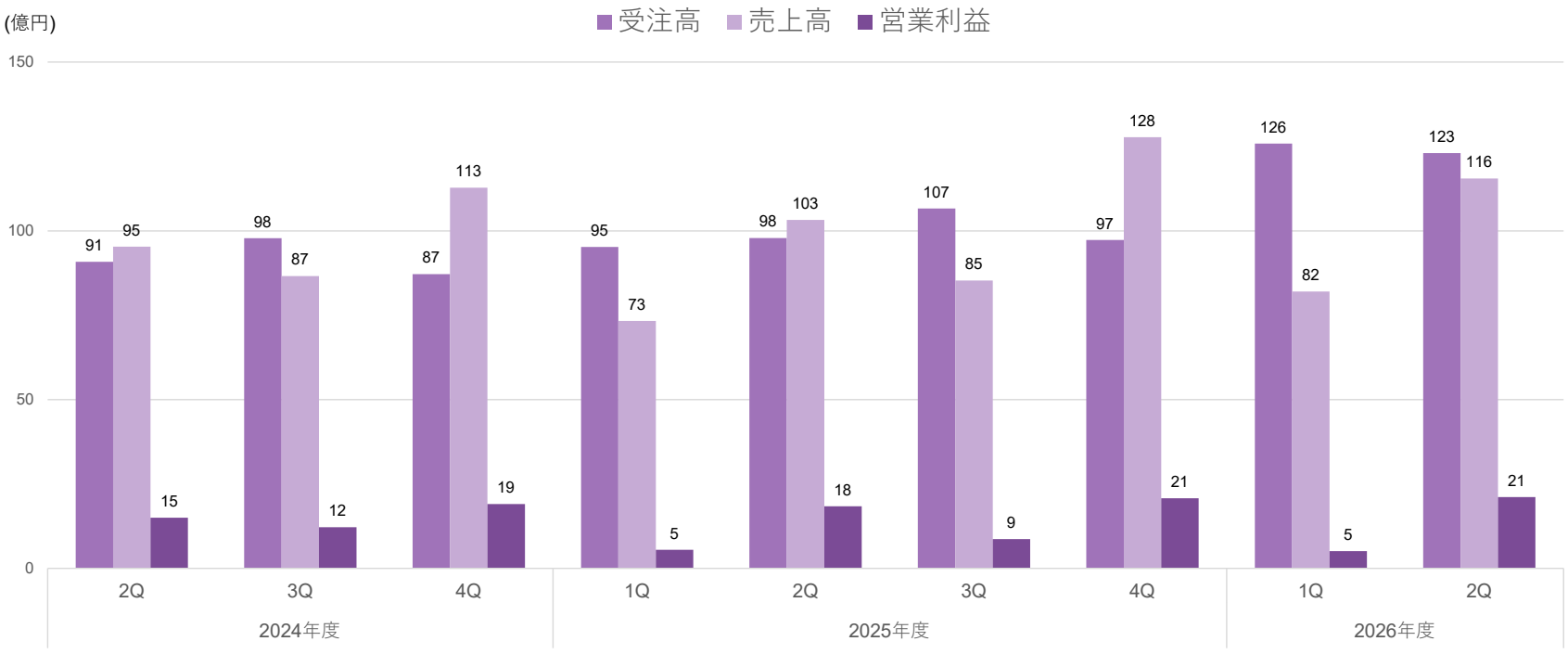
第2四半期の受注高は、引き続きHPC案件・中国案件など 総じて強く、想定を大幅に上回る水準で着地



ACCRETECH | 東京精密

計測機器セグメント　業績推移

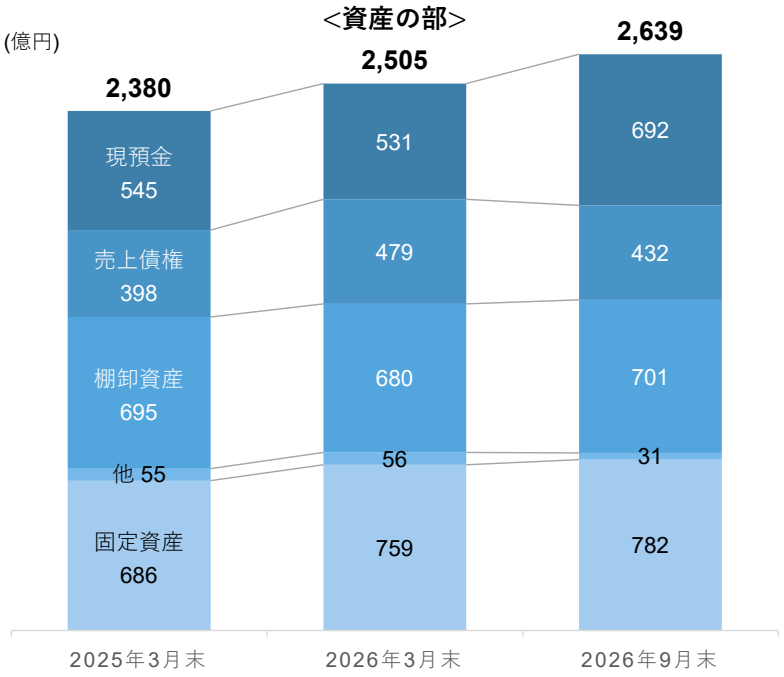
第2四半期の受注高は、HV車生産に関連した追加投資、AIデータセンタ・ロボット等の恩恵を受け高水準

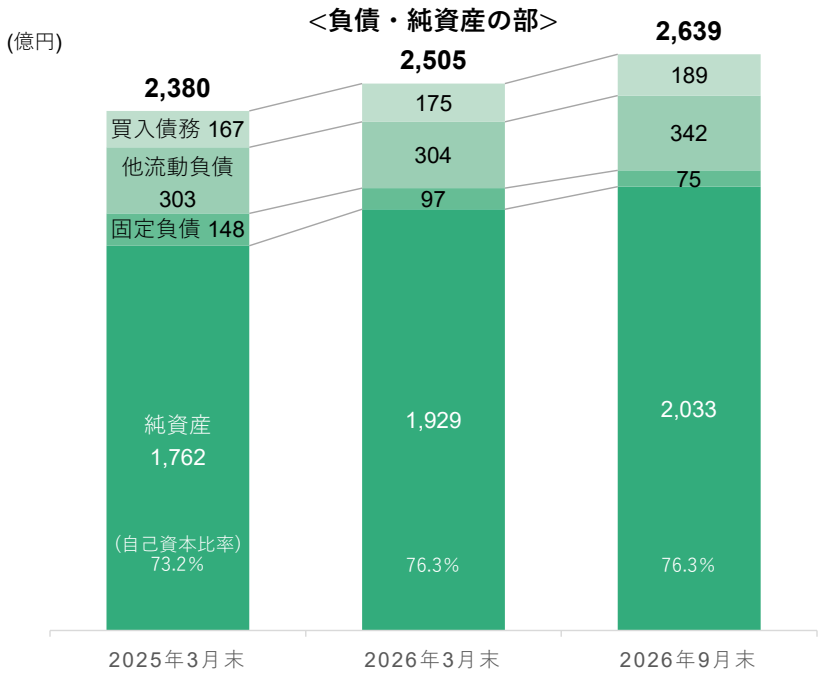


ACCRETECH | 東京精密

貸借対照表

3月末対比で、現預金・棚卸資産・固定資産が増加



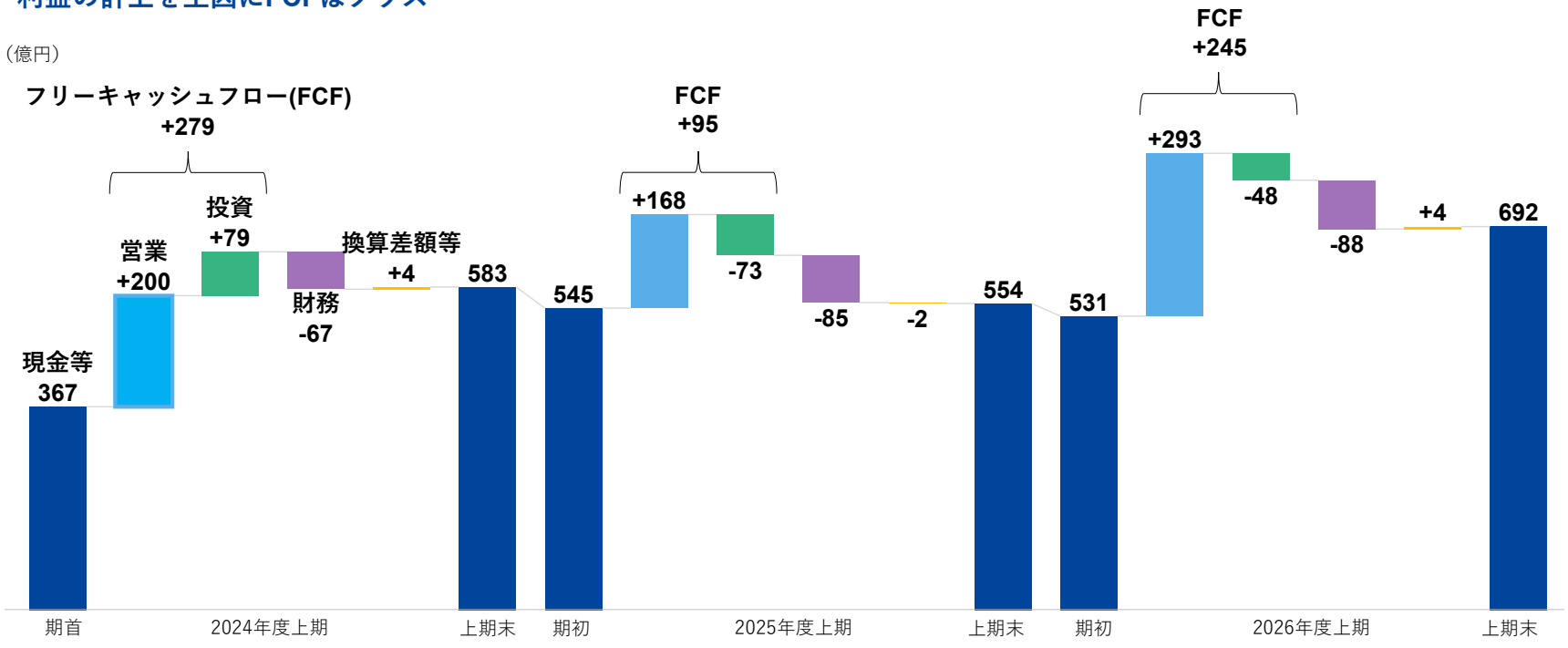


ACCRETECH | 東京精密

キャッシュフロー

利益の計上を主因にFCFはプラス

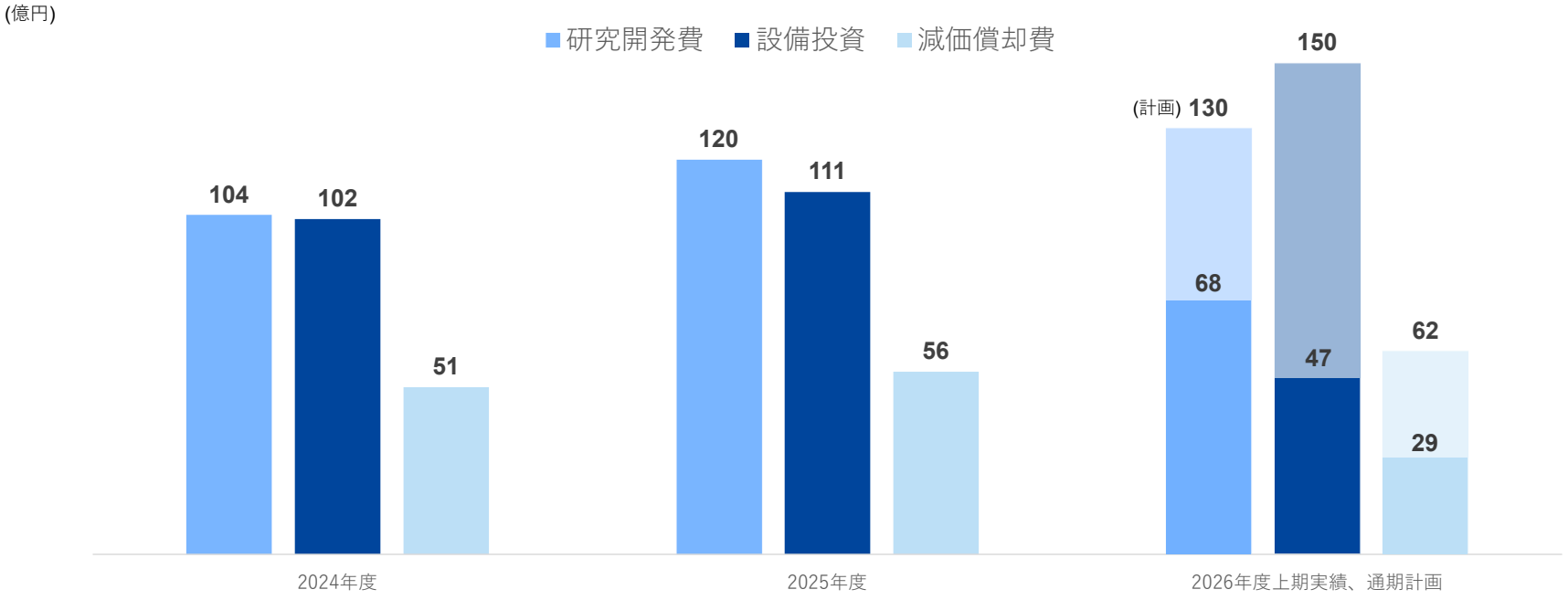
（億円）



ACCRETECH | 東京精密

研究開発費・設備投資・減価償却費

2026年度通期計画は据え置き



ACCRETECH | 東京精密

2026年度通期業績予想の前提 (青字：11月変更)

売上・営業利益

半導体： 上期実績・生産動向・部材調達動向などを総合的に勘案し、通期業績予想を見直し

- 生成AIを含むHPC： 引き続き 売上高・利益に大きく貢献
- グローバルOSAT：HPCのみならず汎用ロジック向けも増加
- 中国需要：ハイエンド需要を中心に高水準
- 汎用メモリ：DRAM/NAND向けの出荷増加

計測：市場全般で成長基調が続く

利益：各種コスト・生産強化に伴う費用増はあるが、中期経営計画の営業利益定量目標に到達の見込み

受注動向

半導体： 下期も非常に堅調な受注動向を想定、通期で2,200億円程度 (前期比約8割増)を見込む

- 生成AIを含むHPC： 堅調さが続くと想定
- グローバルOSAT： 汎用ロジック向けも強い引合いを想定
- 中国需要： ハイエンド需要が継続すると想定
- 汎用メモリ： DRAM/NAND向けの引合いが加速

計測：航空・宇宙・防衛分野、AIインフラ・半導体関連需要の増加、及び補助金の活用による引合増加を想定

2026年度通期業績予想

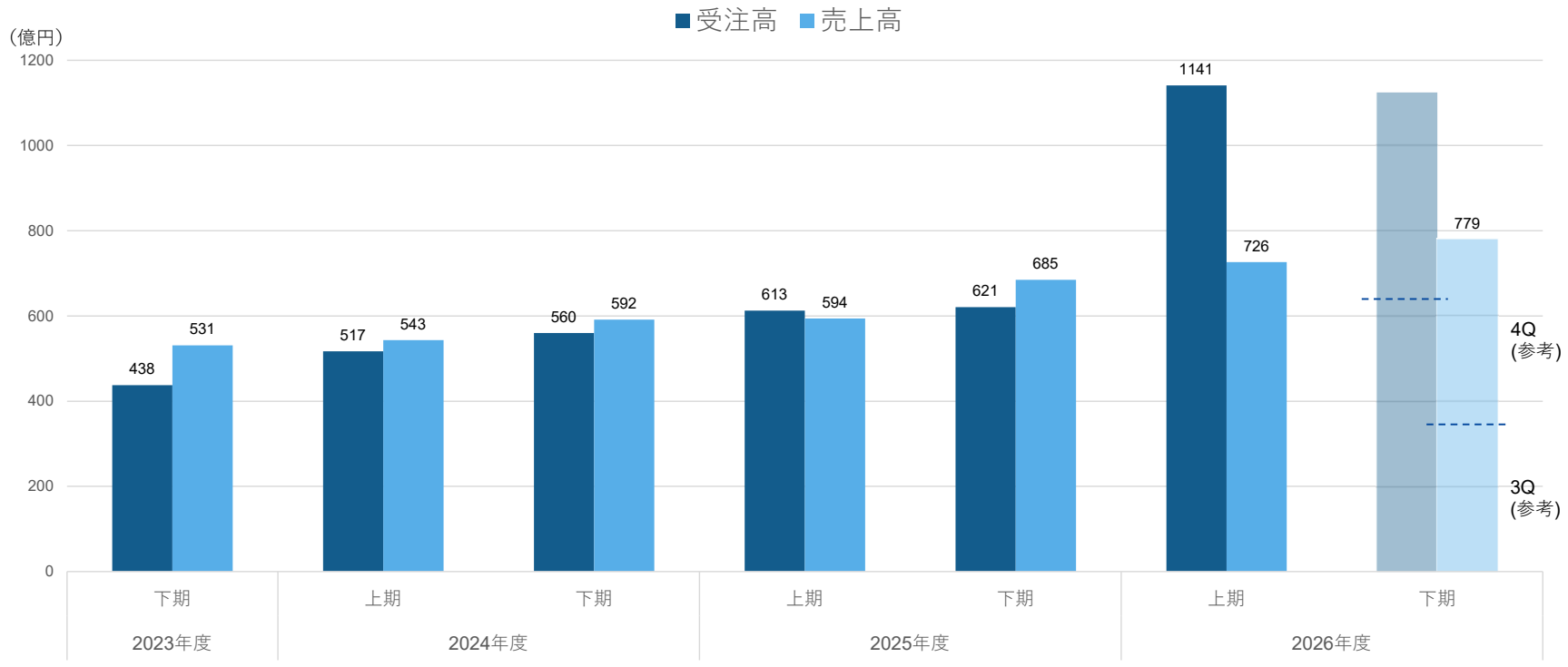
2026年8月4日に開示した業績予想を修正 (半導体を上方修正)
前提為替レートは150円/ドル (為替変動影響は軽微：円建て比率高)で変更なし
業績予想変更に伴い、1株配当予想も変更

全社業績(億円)	2025年度 上期	下期	通期	2026年度 上期	下期予	通期予	前回予想増減	前期比
受注高	806	825	1,631	1,390	-	-	-	-
売上高	771	898	1,668	924	**996**	**1,920**	+30	+15%
営業利益	147	190	337	203	**247**	**450**	+10	+33%
(利益率)	(19.1%)	(21.2%)	(20.2%)	(22.0%)	**(24.8%)**	**(23.4%)**	+0.2pt	+3.2pt
経常利益	150	199	348	211	**244**	**455**	+15	+31%
当期純利益	96	151	247	155	**165**	**320**	+12	+29%
研究開発費	55	65	120	68	**62**	**130**	±0	+8%
設備投資	69	42	111	47	**103**	**150**	±0	+36%
減価償却費	27	29	56	29	**33**	**62**	±0	+11%

セグメント売上高	2025年度上期	下期	通期	2026年度上期	下期予	通期予	前回予想増減	前期比
半導体製造装置	594	685	1,279	726	**779**	**1,505**	+30	+18%
計測機器	177	213	390	198	**217**	**415**	±0	+7%
1株配当(円)	111円	151円	262円	158円	**158円**	**316円**	+12円	+54円

半導体製造装置セグメント– 売上・受注高 半期見込

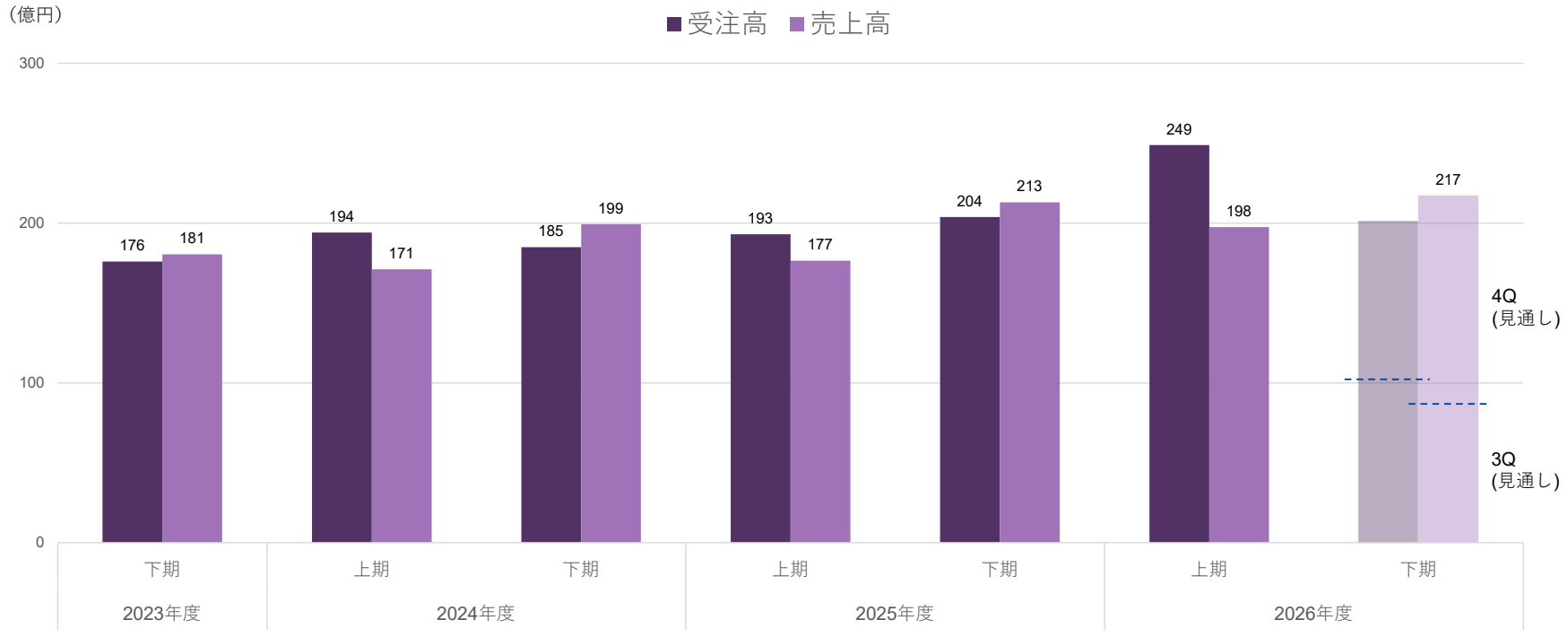
2026年度下期も高水準 (上期なみ)の受注高を想定



ACCRETECH | 東京精密

計測機器セグメント – 売上・受注高 半期見込

例年の季節性を折り込み、2026年度下期の受注は上期比減少を想定 (通期受注高は前期比約1割増を想定)



ACCRETECH | 東京精密

2027年度以降の考え方

半導体製造装置

- 当社対象市場の拡大は最短でも2028年までは続く (プローバ市場 年平均成長率 +20%を想定)
- 2028年度半ばを目途に、プローバの生産可能台数を2026年度上期比で 倍増させる
  - 2026年度：現 飯能工場(埼玉県)の生産スペース増設等(第1フェーズ)により、30前半%引き上げ (前回コメント 20%)
  - 2027年度：現 飯能工場(埼玉県)の生産スペース増設等(第2フェーズ)により、更に20半ば%引き上げ
  - 2028年度：飯能第2工場竣工(第1フェーズ)により、更に20半ば%引き上げ
- 一方で部材調達リスクは要注視。業績予想は部材調達動向を勘案して策定する

計測機器

- ハイブリッド車生産に関連する追加投資の他、航空・宇宙・防衛分野の需要拡大を想定
- AI向けデータセンタ関連(インフラ含む)、自働化・省人化に向けたロボット関連も好調さを維持
- 外需を中心としたものづくり市場拡大傾向が続く

中期経営計画

- 2026年度に現中期経営計画の定量目標を達成することを前提に、 2027年度より新たな中期経営計画を開始したい
- 新中期経営計画の期間・定量目標等については精査中

質疑応答 / Q&A

Supplementary Data - 生成AIを含むHPC / HPC-related business incl. Gen.AI

<売上高/Sales>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度下期 FY2026/3 2H	2026年度上期 FY2027/3 1H	2026年度下期予 FY2027/3 2H (f)
生成AIを含むHPC 全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +32% HoH	前半期比 +48% HoH	前半期比 -5% HoH
うちロジック (生成AIを含む) of which Logic (incl. Gen AI)	前半期比 +11% HoH	前半期比 +105% HoH	前半期比 -3% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 +64% HoH	前半期比 -8% HoH	前半期比 -12% HoH
SPE売上高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE sales	30%半ば / Mid-30%	50%	40%半ば / Mid 40%

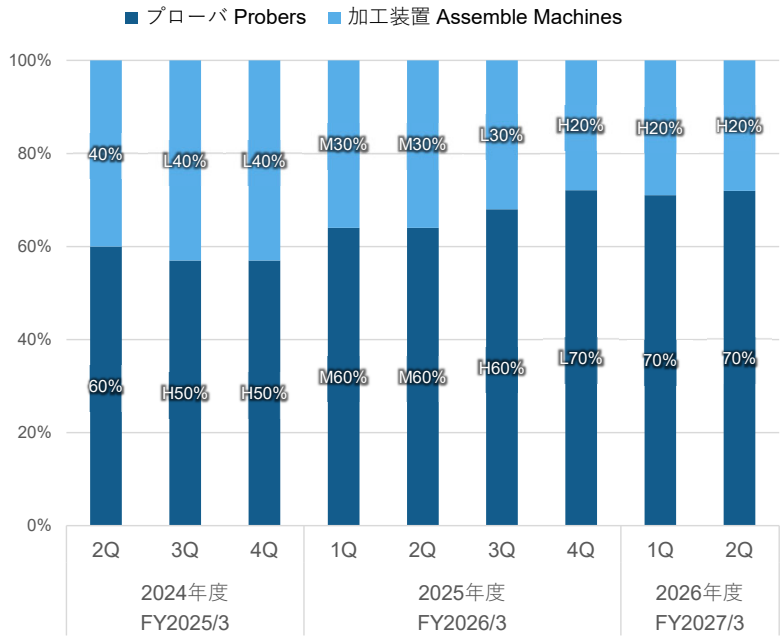
<受注高/Orders>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度下期 FY2026/3 2H	2026年度上期 FY2027/3 1H	2026年度下期予 FY2027/3 2H (f)
生成AIを含むHPC 全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +4% HoH	前半期比 +90% HoH	前半期比 +6% HoH
うちロジック (生成AIを含む) (*) of which Logic (incl. Gen AI) (*)	前半期比 +84% HoH	前半期比 +83% HoH	前半期比 +3% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 -48% HoH	前半期比 +105% HoH	前半期比 +12% HoH
SPE受注高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE orders	40%	40%	40%半ば / Mid 40%

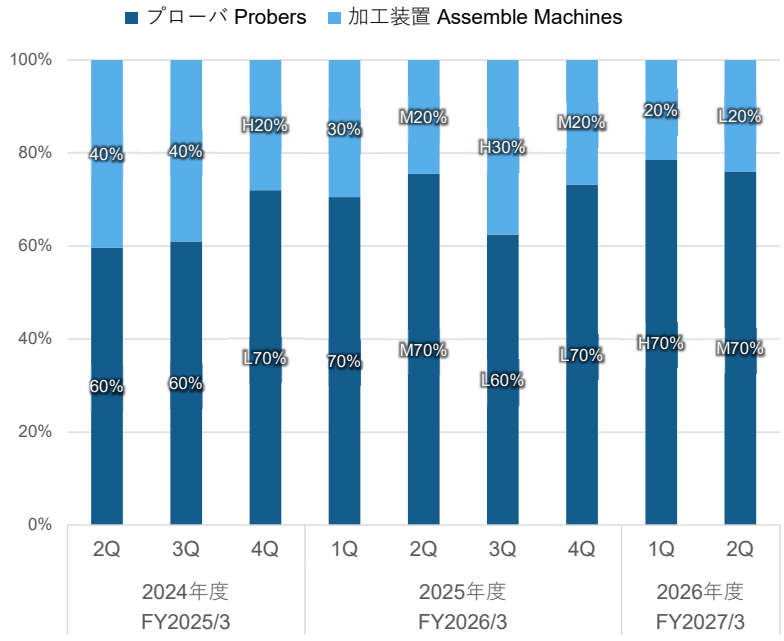
- 変動が大きいため、四半期別の開示は行っておりません。 Due to significant volatilities, the Company does not provide quarterly forecasts.
- 『生成AIを含むHPC全体』は、「うちロジック(生成AIを含む)」および「うちHBM」の合計です。「うちロジック(生成AIを含む)」には、ロジックデバイス向けプローバやAIパッケージング向けの加工装置の需要が含まれています。なお、当社は製品の特性上、検査や加工がおこなわれる半導体デバイスの種別を特定することが困難であることから、生成AIに限定した分類は行っておりません。“HPC-related incl. Gen.AI” represents the sum of ‘of which Logic (incl. Gen.AI)' and ‘of which HBM’. The ‘of which Logic (incl. Gen. AI)' encompasses businesses for probers for logic devices and assembly equipment for AI packaging. Note that due to the nature of our products, it is difficult to identify the specific types of semiconductor devices undergoing inspection or processing; consequently, the Company does not undertake classification limited solely to Generative AI.

Supplementary Data - 製品別構成比 半導体 / SPE Segment per Product

<売上高　Sales>



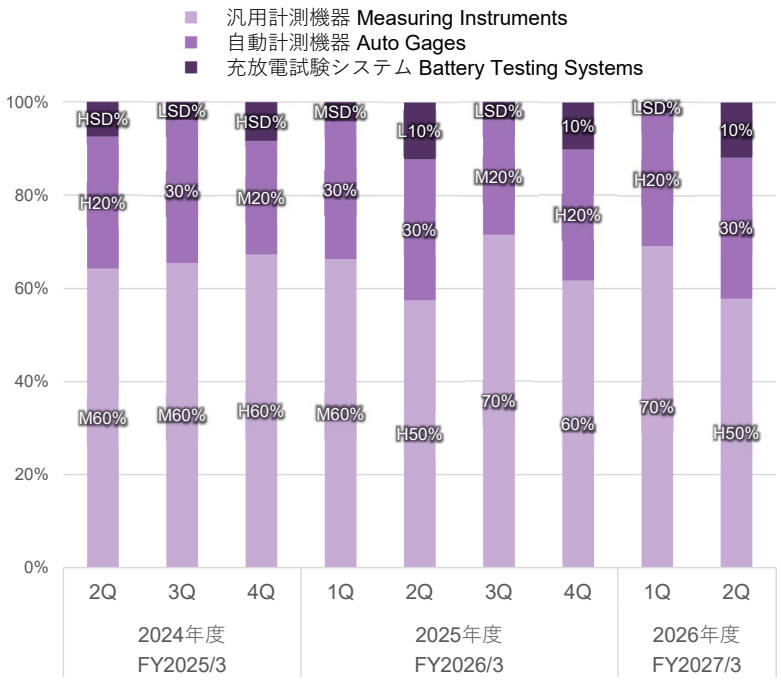
<受注高　Orders>



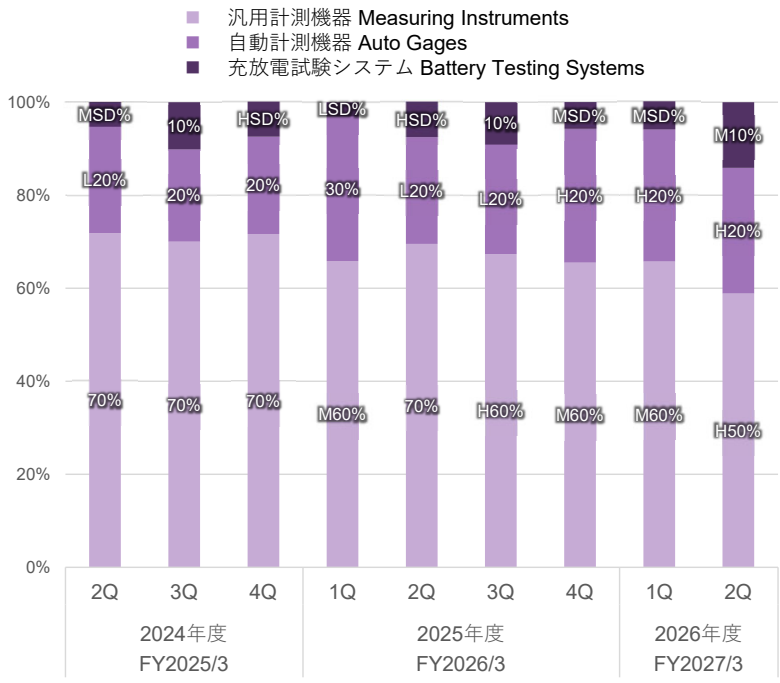
備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%) 、MSD% :一桁%半ば (4-6%)、HSD%:一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4–6%), and HSD%: High Single Digit % (7–9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - 製品別構成比 計測 / Metrology Segment per Product

<売上高　Sales>



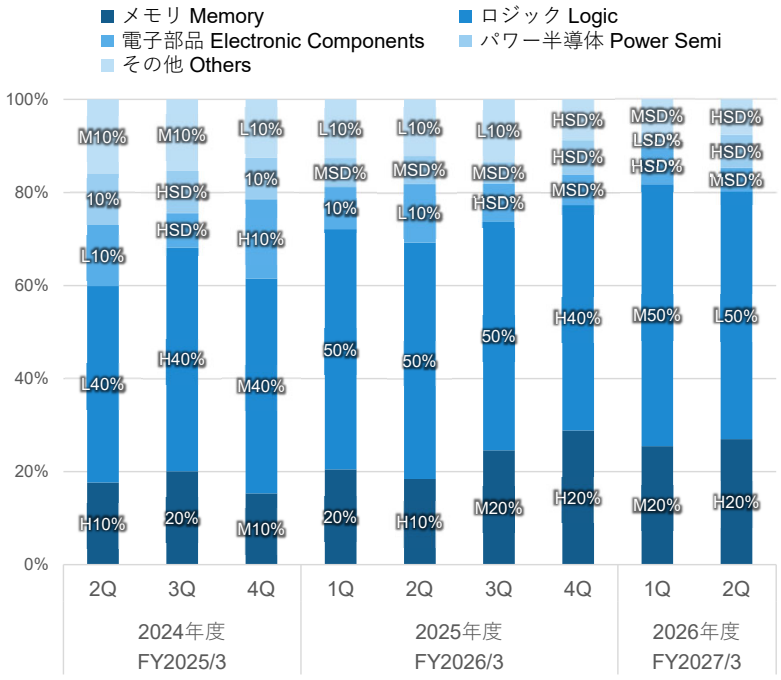
<受注高　Orders>



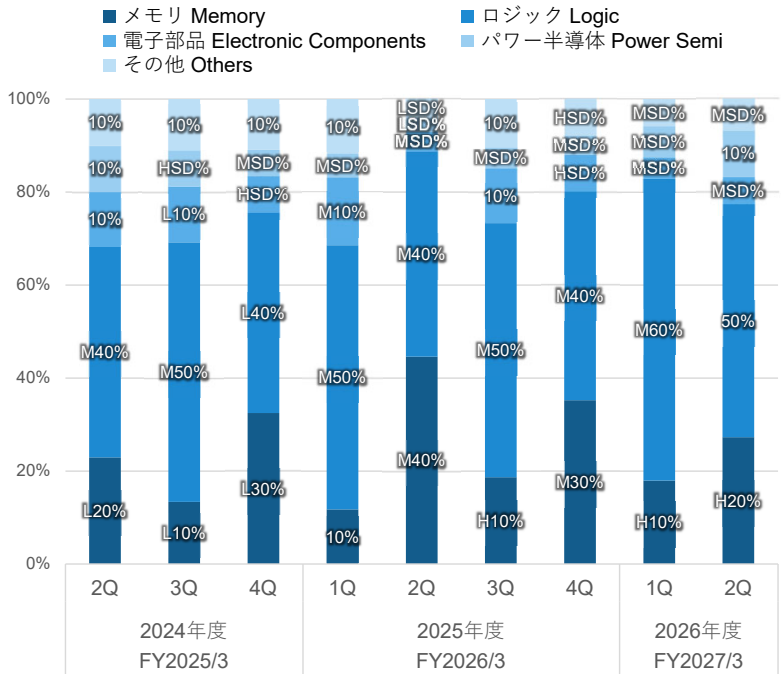
備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%) 、MSD% :一桁%半ば (4-6%)、HSD%:一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4–6%), and HSD%: High Single Digit % (7–9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - アプリ別構成比 半導体 / SPE Segment per Application

<売上高　Sales>



<受注高　Orders>

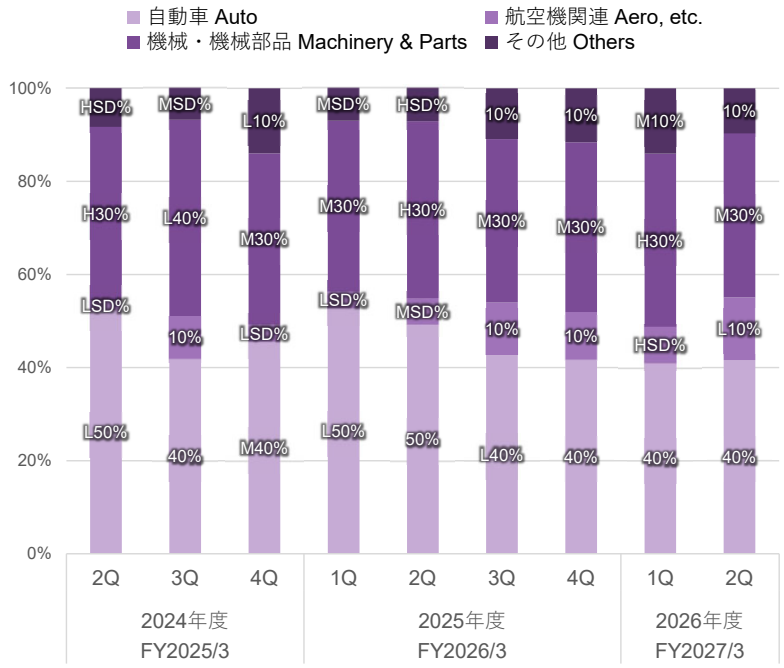


備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%) 、MSD% :一桁%半ば (4-6%)、HSD%:一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4–6%), and HSD%: High Single Digit % (7–9%), respectively. SUM may not equal 100%.

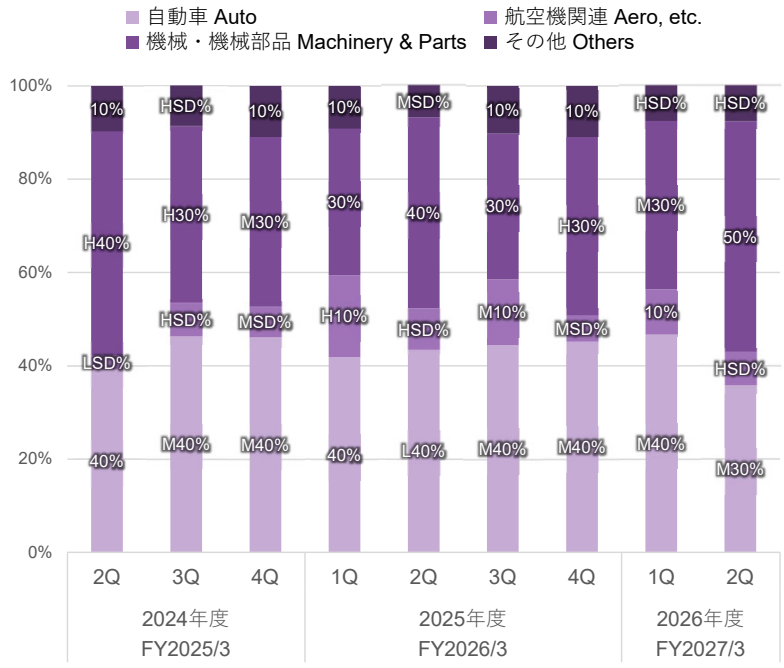
注) 2026年8月4日に開示した構成比データ(売上高、左側)に誤りがありましたので訂正しております。
Note: We have corrected the composition data (sales, left side) disclosed on August 4, 2026, as it contained an error.

Supplementary Data - アプリ別構成比 計測 / Metrology Segment per Application

<売上高　Sales>



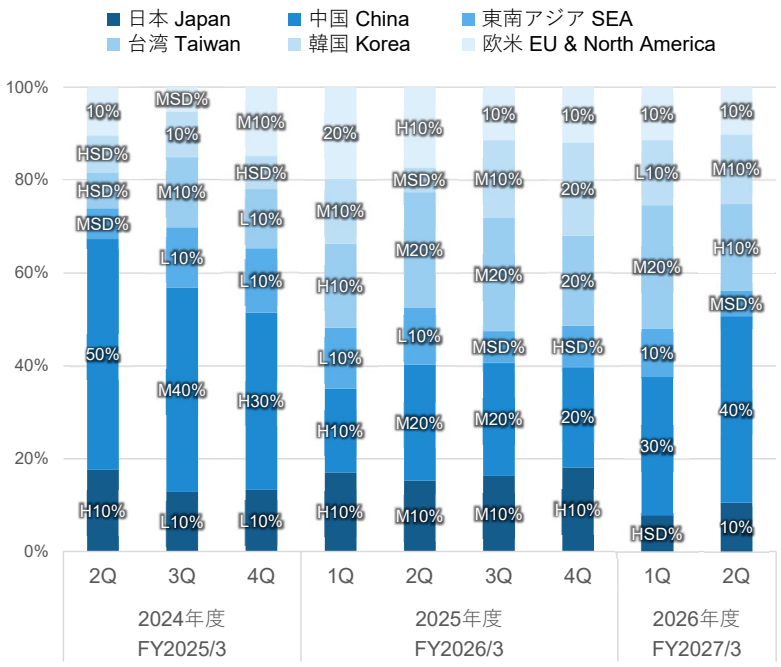
<受注高　Orders>



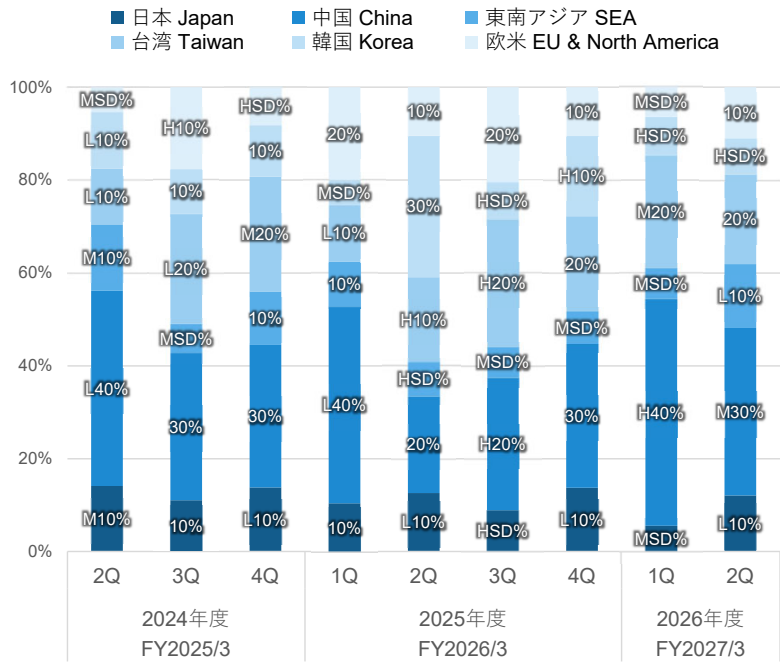
備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%) 、MSD% :一桁%半ば (4-6%)、HSD%:一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4–6%), and HSD%: High Single Digit % (7–9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - 地域別構成比 半導体 / SPE per Region

<売上高　Sales>



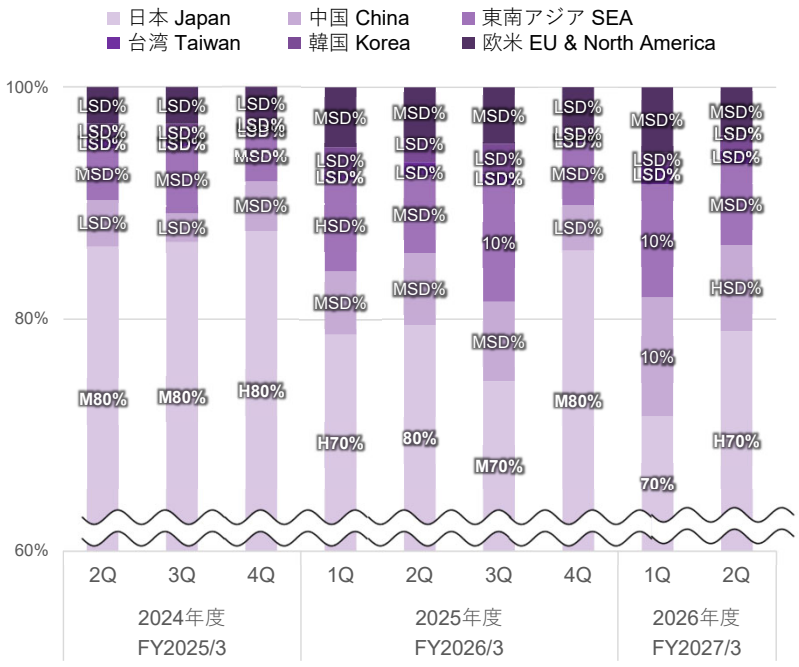
<受注高　Orders>



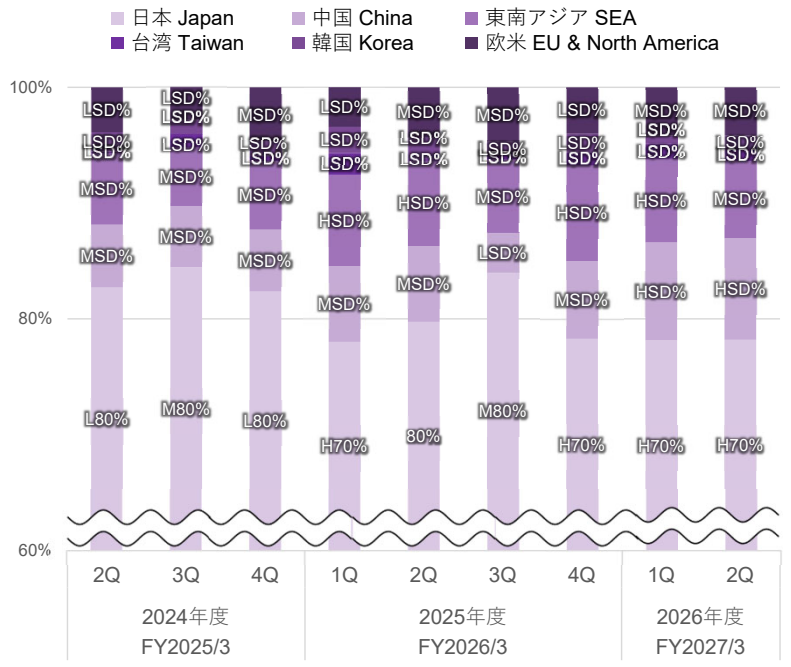
備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%) 、MSD% :一桁%半ば (4-6%)、HSD%:一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4–6%), and HSD%: High Single Digit % (7–9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - 地域別構成比 計測 / Metrology per Region

<売上高　Sales>



<受注高　Orders>



備考：取引顧客の国籍による分類であり、日本向け売上高・受注高には第3国への輸出案件が含まれています。This data classifies based on customers' nationality. Sales and orders for Japan include export transactions to third countries.

備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD% : 一桁%前半 (0-3%) 、MSD% :一桁%半ば (4-6%)、HSD%:一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4–6%), and HSD%: High Single Digit % (7–9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

(百万円) Million Yen		連結会計期間 Consolidated Fiscal Year				四半期 Quarterly							
		2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3	2026年3月期 FY2026/3				2027年3月期 FY2027/3			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
受注高 Orders	半導体 SPE	99,366	86,082	107,713	123,396	26,378	34,945	25,965	36,106	53,236	60,837		
	計測 Metr.	36,960	34,802	37,917	39,700	9,523	9,786	10,661	9,728	12,583	12,302		
	合計 Total	136,326	120,885	145,631	163,096	35,901	44,732	36,627	45,835	65,820	73,140		
受注残高 Backlog	半導体 SPE	89,371	75,398	69,630	65,149	72,466	71,541	70,134	65,149	89,870	106,577		
	計測 Metr.	12,428	12,606	13,470	14,210	15,660	15,123	17,257	14,210	18,592	19,343		
	合計 Total	101,799	88,004	83,101	79,359	88,127	86,664	87,391	79,359	108,463	125,921		
売上高 Sales	半導体 SPE	112,365	100,055	113,481	127,878	23,542	35,870	27,372	41,092	28,515	44,130		
	計測 Metr.	34,436	34,624	37,053	38,960	7,333	10,323	8,528	12,775	8,201	11,552		
	合計 Total	146,801	134,680	150,534	166,839	30,876	46,194	35,900	53,867	36,716	55,682		
営業利益 OP	半導体 SPE	29,866	19,899	24,311	28,404	4,031	8,297	5,347	10,727	5,409	12,308		
	計測 Metr.	4,628	5,408	5,392	5,333	549	1,838	867	2,077	511	2,112		
	合計 Total	34,494	25,307	29,703	33,738	4,581	10,136	6,214	12,805	5,920	14,420		
営業利益率 OP Margin	半導体 SPE	26.6%	19.9%	21.4%	22.2%	17.1%	23.1%	19.5%	26.1%	19.0%	27.9%		
	計測 Metr.	13.4%	15.6%	14.6%	13.7%	7.5%	17.8%	10.2%	16.3%	6.2%	18.3%		
	合計 Total	23.5%	18.8%	19.7%	20.2%	14.8%	21.9%	17.3%	23.8%	16.1%	25.9%		

Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

(百万円 (EPS除く)) Million Yen(excl. EPS)	連結会計期間 Consolidated Fiscal Year				四半期 Quarterly							
					2026年3月期 FY2026/3				2027年3月期 FY2027/3			
	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	146,801	134,680	150,534	166,839	30,876	46,194	35,900	53,867	36,716	55,682		
売上原価 Cost of goods sold	84,967	79,917	88,081	97,978	18,468	27,411	21,063	31,034	21,316	31,579		
売上総利益 Gross Profit on Sales	61,834	54,762	62,453	68,860	12,407	18,783	14,837	22,832	15,400	24,102		
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	27,339	29,454	32,750	35,122	7,825	8,647	8,622	10,026	9,479	9,681		
営業利益 Operating profit	34,494	25,307	29,703	33,738	4,581	10,136	6,214	12,805	5,920	14,420		
営業外収益 Non-operating income	965	1,404	921	1,481	133	309	609	428	576	385		
営業外費用 Non-operating expenses	162	259	684	394	252	-69	84	126	66	90		
経常利益 Recurring Profit	35,297	26,453	29,939	34,825	4,462	10,515	6,739	13,108	6,430	14,715		
特別利益 Extraordinary gains	103	824	4,493	194	3	85	105	0	3	126		
特別損失 Extraordinary losses	2,099	21	158	1,833	-	2,103	-	-269	-	-		
税金等調整前当期/四半期純利益 Profit before income taxes and minority interests	33,301	27,255	34,275	33,186	4,465	8,498	6,844	13,377	6,434	16,540		
法人税等合計 Total Income tax and others	9,607	7,791	8,531	8,354	1,228	2,090	2,268	2,768	1,698	4,006		
非支配株主に帰属する当期/四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	62	84	106	92	7	25	39	18	67	13		
親会社株主に帰属する当期/四半期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	23,630	19,378	25,637	24,739	3,229	6,382	4,536	10,590	4,667	10,821		
1株当たり当期/四半期純利益(円) Net Profit per Share(Yen)	581.33	480.49	633.75	610.02	79.77	157.32	112.74	260.73	115.01	266.61		
潜在株式調整後 1株当たり当期/四半期純利益(円) Net Profit per Share(diluted)(Yen)	575.62	475.42	628.31	606.14	-	-	-	-	-	-		

Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

(百万円)(Million Yen)		2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3	2027年3月期 中間期 FY2027/3 Interim
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	36,782	54,541	53,073	69,219
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	42,801	39,809	47,877	43,229
	棚卸資産 Inventories	67,225	69,513	68,022	70,125
	その他 Others	7,022	5,477	5,634	3,106
	合計 Total	153,831	169,341	174,607	185,680
固定資産合計 Total Fixed Assets		71,693	68,610	75,925	78,228
総資産 Total Assets		225,524	237,952	250,533	263,909
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	17,845	16,665	17,529	18,898
	その他 Others	28,156	30,268	30,350	34,245
	合計 Total	46,002	46,933	47,879	53,144
固定負債合計 Total long-term liabilities		21,094	14,789	9,737	7,478
負債合計 Total Liabilities		67,097	61,723	57,617	60,623
純資産合計 Total Net Assets		158,427	176,229	192,916	203,285
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		225,524	237,952	250,533	263,909
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		25,171	20,084	14,713	12,190
自己資本比率 Equity Ratio(%)		69.4%	73.2%	76.3%	76.3%
自己資本利益率 ROE(%)		12.9%	15.5%	13.5%	13.6%

※1: 電子記録債権、契約資産を含みます。 Incl. Electronically recorded monetary claims.
※2: 電子記録債務を含みます。 Incl. Electronically recorded obligations-operating.

Supplementary Data - 各種費用, キャッシュフロー/ Expenses and Cash

(百万円)(Million Yen)	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3	2027年3月期中間期 FY2027/3 Interim
研究開発費　R&D expenses	9,042	10,354	12,037	6,769
設備投資　Capex	11,602	10,245	11,069	4,696
減価償却費（のれんの償却を除く） Depreciation（excl. Amortization of goodwill）	4,673	5,105	5,582	2,940

(百万円)(Million Yen)	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3	2027年3月期 中間期 FY2027/3 Interim
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	4,892	28,824	25,012	29,338
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-10,563	2,541	-11,491	-4,827
フリーキャッシュフロー Free cash flows	-5,671	31,365	13,520	24,511
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	1,616	-13,991	-15,674	-8,797
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	755	404	689	432
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	36,736	54,516	53,052	69,198

(従業員) (# of Employees)	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3	2027年3月期中間期 FY2027/3 Interim
正社員合計　Total full-time employees	2,658	2,767	2,890	2,994
期間平均臨時従業員数 (外書) Average number of part-time employees, not included in the above figure	1,225	1,258	1,365	1,394
従業員合計 (※1)　Number of employees	3,883	4,025	4,255	4,388

※1: 従業員合計は、正社員合計人数と、期間平均臨時従業員数の単純合算です。“Number of employees” is a simple sum of the total number of regular employees and the average number of temporary employees during the period.